(上接D10版)

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业总收入116,123.76万元，较上年增长49.37%；利润总额13,094.51万元，较上年增长46.19%；归属于上市公司股东的净利润11,187.12万元，较上年增长45.02%。截至2010年底，公司资产总额174,150.49万元，净资产101,821.08万元，资产负债率41.53%，经营活动产生的现金流量净额29,249.28万元，公司资产质量和财务状况良好。

二、对公司未来发展的展望

(一)我国集成电路行业的快速发展与国内集成电路市场供给不足的矛盾依然持续

1.未来集成电路封装市场仍将保持较高速度的增长

随着科技进步和市场发展，我国集成电路产业发展迅速。根据CCID预计，2010年我国集成电路市场规模将达到6669.3亿元，同比增长17.5%，到2015年市场规模将达到11088.2亿元，年平均增速在10%以上。

根据CCID初步统计，2010年国内集成电路销售额将大幅增长29.60%，规模达到1430亿元。

部分行业中，封装测试业产品种类和产量较过去均有较大提高，近几年呈稳定增长趋势，并在我国集成电路产业规模快速增长的环境和新建项目建成投产的带动下呈现增幅上扬的势头。根据CCID预计，到2015年我国封装测试业的销售额达到954亿元，年均增长率达到11.45%。

根据半导体行业协会在2011年1月25日初步统计，2010年国内封装测试业销售632亿元，同比增长26.8%，封装测试业统计情况好于CCID年初预测。

2.国内集成电路市场供给不足

根据海关总署统计，2010年1-11月国内进口集成电路金额为1431.5亿美元，同比增长34%；2010年1-11月国内出口集成电路金额265.9亿美元，同比增长28.8%，巨大的供需缺口也使我国集成电路企业具有通过替代进口来实现其增长的空间。

国内集成电路封装测试业占整个产业的比重接近50%，封装能力同样远不能满足快速增长的市场需求。

(二)集成电路封装技术的发展趋势

1.电子整机系统的发展对集成电路封装技术提出更高的要求

随着科技水平的不断提高，电子整机系统在消费类产品领域如MP3、数码相机、电子钟表、电子玩具等都在向轻、薄、小型化、便携化方向发展；在我国数字电视地面传输标准出台后，数字电视及其配套设备将马上进入大规模生产，成为未来消费电子领域最大的推动力。数字电视将叫以液晶电视和PDP为代表的大屏幕、轻、薄型方向发展；此外，在计算机和通讯领域，以笔记本电脑和手机为代表的集成度较高产品，轻、薄、多功能、低功耗成为共发展的方向。

电子整机系统的应用需求对集成电路的设计、制造和封装测试提出了更高的要求，电子系统的小型化和高性能化除受集成电路设计、制造影响外，集成电路的封装对电子整机系统尺寸和性能的影响已变得与芯片本身的影响同等重要。先进的集成电路封装技术的发展，指向着电子装备不断升级换代、指向着电子信息技术高速发展。具体而言，集成电路产品的发展表现为：线宽更小、I/O更多、频率更快、集成度更高、电压更低、输出电流更大。

因此，集成电路封装从传统的DIP型向小外形SOP、薄型TSOP、四边引线扁平QFP、焊球阵列BGA、无引脚封装QFN、多芯片组装MCM及芯片尺寸封装CSP等表面贴装式集成电路封装形式方向发展。

我国集成电路封装产业虽然发展迅速，但与我国对集成电路的巨大需求相差甚远，封装能力和技术严重不足，目前国内企业整体技术水平为国际90年代初中期水平，大部分集成电路封装企业生产的封装产品仍以PDIP、TO和SOP等低端产品为主，能封装QFP、QFN、DFN、BGA、LGA等系列高端集成电路产品的企业不仅很少而且产能很低。而国际先进集成电路封装企业已向高端集成电路封装方面快速迈进，国际封装技术的快速发展，要求我们必须加速发展集成电路封装产业和封装技术，才能跟上国际集成电路封装的发展，参与国际国内封装市场竞争。

2.倒装键合为集成电路封装提供了更多的材料选用途径

引线键合是集成电路封装中的一项关键工艺技术，是指在一定温度下，采用超声加压的方式，将引线两端分别焊接在芯片焊盘上和引线框架或PCB板上，实现芯片内部与外部电路的连接。由于金丝在封装中具有电导率大，良好的抗腐蚀性，抗氧化性，延展性等优点，在集成电路封装上得到广泛应用，集成电路封装成本中金丝所占比重最大。为了降低成本，提高可靠性，必将寻找工艺性能好、价格低廉的其他金属材料来代替价格昂贵的金丝。铜丝具有价格低，力学性能、电学性能、热学性能好的优点，铜丝成本只有金丝成本的5-10%左右，并且在拉伸、剪切强度和延展性等方面优于金丝。铜丝键合工艺技术也成为目前国际上正在进行研究开发的一种用于微电子器件芯片与内引线连接的新技术，并成为今后微电子封装发展中的主流封装技术。

(三)公司未来发展的机遇与挑战

1.公司未来发展的机遇

①国家政策重点支持集成电路产业的发展

基于集成电路对于国民经济和国家安全的高度重要性，中国政府对集成电路产业的发展给予了一贯的高度关注，并先后采取了多项优惠措施。2000年1月，财政部和国家税务总局发布了《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2000]25号)，对集成电路企业所享受的所得税优惠政策进一步给予明确。2009年2月通过的《电子信息产业调整振兴规划》中，更是将“建立自主可控的集成电路产业体系”作为未来国内信息产业发展的三大重点任务之一，并在五大发展举措中明确提出“加大投入，集中力量实施集成电路升级”。2011年1月28日，国务院出台了关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发[2011]4号)，为促进我国鼓励软件产业和集成电路产业发展，从财税、投融资、研发开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予以明确的政策支持，且具体实施办法正在加紧制定当中。

②《长江三角洲地区区域规划》及产业转移政策导向将对公司发展产生深远影响

2009年6月，国家发展和改革委员会审议通过了《长江三角洲地区发展规划》，旨在充分利用长江三角洲地区在科技优势、区位条件和产业基础，构建创新型区域，引导创新要素向企业集聚，形成特色产业集群。其中，电子信息产业作为重点推进的行业之一，研发创新、成果转化及知识产权保护将迎来机遇和完善。

2010年2月24日，国务院常务会议在《关于促进经济平稳较快发展的若干意见》中指出：要优化产业布局，严格市场准入，强化投资管理，做好专项转移，建设先进制造业基地和现代产业集群，推动电子信息、轻工、纺织等产业向中西部地区加快转移。“转移的政策导向将对公司发展产生深远影响。

②随着研发创新能力的逐步加强和高端封装产业化项目的实施，公司步入科技成果产业化、技术创新、结构优化上升通道

①公司通过对铜线球焊氧化技术、高密度窄间距低弧度防弹坑球焊技术和高密度窄间距封装技术的攻关，开发出了一套适合各种规格铜线和封装品质的压焊工艺。该技术达到国内领先、国际先进水平，被评为第四届2009年度中国半导体创新技术，并申报了发明专利和实用新型专利。目前，公司铜线键合技术可封装DIP、SOP、SSOP、TSSOP、QFN、QFP、LQFP等多个系列产品，具备了月产18000万只的能力。

②公司已具备12英寸晶圆加工能力，超薄减薄技术得到突破，12英寸晶圆最小减薄厚度50um，采用划裂和细磨抛光工艺，保证了晶圆无破片、无碎片，可满足多层叠加3D封装和Sip等高端封装需要，实现了芯片厚度为75um的5层堆叠和三层隔片MCP封装。

③公司已在BGA/LGA等高端封装领域获得重大突破。通过自主设计和研发，公司先后成功开发了LFBGA/TFBGA/LGA等多个项目，除常规BGA封装工艺外，超细间finger pitch技术及business工艺压焊技术，有效提高了设计密度。目前BGA项目终端应用已扩展到sink电子书、高清电视、数字机顶盒、MID、手机用NOR Flash Memory、机卡一体等市场。

④公司已切入高端SiP System in Package 封装领域，先后掌握了DAF (高效的堆叠芯片技术)，die to die、over die等技术，解决了高密度SiP封装中的塑封表流等关键难题，掌握了MCM side by side)、stack die等高密度封装的技术，并成功实现超薄封装技术。通过SiP超薄封装技术的应用，嵌入式手机RF-SIM卡已通过了电性能测试，比目前市场上流行的RF-SIM卡封装密度更高、厚度更薄、面积更小，在手机银行、智能手机、MID、CMMB等移动应用领域，具有广阔的市场前景。

⑧再融资项目投资将为公司跻身国内外一流封装企业创造契机

2010年12月22日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了非公开发行股票事宜。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过83,400万元，扣除发行费用后净额将用于《年产80亿颗小形封装集成电路封装工艺升级及产业化项目》、《集成电路高端封装测试生产线技术改造项目》和《集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目》建设，若本次募集资金不能满足拟投入项目金额的，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

公司本次非公开发行是紧跟行业发展机遇，进一步完善产业链，增强盈利能力，做大，做强，做优主业，实现股东利益最大化的需要，也将为公司跻身国内外一流封装企业创造契机。

2.公司实现经营目标和发展战略存在的风险因素及应对措施

①原材料价格及应对措施：

公司实施的《集成电路高端封装产业化项目》和《DFN型微小形封装集成电路生产线技术改造项目》均已建设完成，产能将有大幅度的提升，封装技术水平也将不断提高，对公司质量管理等方面提出了更高要求。为此，公司一方面继续完善人力资源管理制度，创造良好的工作生活环境，进一步拓宽渠道，加强人才引进和优秀员工培养力度；另一方面要求让用户满意的质量方针，制订并实施质量规划，对设计、工艺、生产、供方控制、检验控制、人员培训及质量责任追溯等涉及质量管理的各方面都进行详细规划和落实。

②客户结构相对集中的挑战及应对措施

截至2010年底，公司有接近80%的销售收入来自国内IC设计企业，随着公司产品向高端演进，将逐步在高端市场上展开竞争，能否获得更多国际IDM公司(工厂型设计公司和综合性半导体公司)产品和市场空位，为此，公司采取如下应对措施：

A.继续完善营销网络体系

目前通过在北京、上海、无锡、珠三角地区等地设立销售服务点，建立了全国范围内的营销网络体系，今后还将通过多种方式开展客户关系建设工作。

B.注重品牌效应，实施名牌战略

公司将继续加大宣传华天品牌，打造名牌产品，并争取主要产品列入国家重点新产品计划，火炬计划、863计划、科技成果推广计划等，增强知识产权保护意识，注意培养名牌的持久竞争力和美誉度。

C.积极开拓国际市场，扩大产品出口

公司将紧抓机遇，掌握国际游戏规则，熟悉国际法律和惯例，做好各种质量标准的审核认证工作，如QS9000体系认证、美国UL认证、欧盟的安全标准认证等，为产品出口拿到通行证，不失时机地开拓海外市场，扩大产品出口。

③外部挑战及应对措施

随着下游集成电路应用行业的迅速发展，将会不断有新的竞争者加入；而且随着国外、台湾等地区的集成电路封装企业不断向大陆产业转移，市场竞争将会进一步加剧。根据CCID的统计显示，目前外资企业在芯片制造和封装测试销售收入中所占比重已经超过80%，这对国内处于起步阶段的本土企业来说无疑意味着巨大的竞争压力。为此，公司采取如下措施：

①继续强化成本控制，利用好“电子信息产业调整和振兴规划”、“聚电下乡”、“聚电以旧换新”等拉动内需的政策之利，保护市场潜力。

②紧抓国家推行的战略性新兴产业之机，积极申报并组织实施好重大专项建设，提高产品技术含量和附加值，积极开展产品验证，承接更多转移订单，逐步建立和完善行之有效的用户需求解决机制。公司最终通过开发、量产LQFP、TSSOP、QFN、BGA、LGA、MCM等高端封装产品和优化客户结构的方式提高参与市场竞争的能力。

(二)公司2011年度的经营计划

1.2011年度生产经营目标为全年实现销售额16亿元(含西安天胜电子有限公司)，生产经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

2.争取非公开发行股票事宜早日完成，加快《集成电路高端封装工艺升级及产业化项目》、《集成电路高端封装测试生产线技术改造项目》和《集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目》建设，为公司“十二五”发展规划奠定基础。本次非公开发行尚需经公司股东大会批准并经中国证监会核准，存在不确定性，请投资者特别注意。

(三)投资规划资金需求，使用计划以及资金来源情况

公司发展规划资金需求主要为日常生产经营，市场开发以及项目投资需求，资金来源主要为自有资金(含火灾补充流动资金的结余募集资金)，银行贷款或非公开发行募集资金。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集成电路封装产品	116,123.76	89,310.36	23.09%	49.37%	49.64%	-0.14%
主营业务分产品情况						
集成电路封装产品	116,123.76	89,310.36	23.09%	49.37%	49.64%	-0.14%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	93,190.80	80.25%
出口销售	22,932.96	19.75%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		44,172.30	本年度投入募集资金总额		12,305.76
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		41,060.99
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
集成电路高端封装产业化	否	44,172.30	44,172.30	12,305.76	41,060.99	92.96%	2010年12月20日	6,477.78	否	否
承诺投资项目小计	-	44,172.30	44,172.30	12,305.76	41,060.99	-	-	6,477.78	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-						-		-	-
合计	-	44,172.30	44,172.30	12,305.76	41,060.99	-	-	6,477.78	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 受2008年的经济危机影响，2008年第四季度至2009年上半年期间，公司订单下滑明显，为了规避募集资金项目投资风险，经2009年9月28日召开的第二届董事会第十六次会议和2009年10月18日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过，公司将集成电路高端封装产业化项目建设期限延期一年至2010年底。2009年下半年至今，随着集成电路行业的逐步复苏以至繁荣，公司加快集成电路高端封装产业化项目实施进度，截止2010年12月20日，项目已完成建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 适用

经2008年6月18日召开的第二届董事会第九次会议和2008年7月13日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过，公司将募集资金中1亿元的实施地点变更为西安经济技术开发区，实施主体变更为公司全资子公司西安天胜电子有限公司，实施项目内容不变，仍为集成电路高端封装产业化项目。本次实施主体、地点变更后，可以有效满足项目对厂房、人才的需求，并有利于改变地域位置的劣势，进一步开拓国际市场。

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用

2008年3月24日，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司以28,258,525.30元置换预先投入集成电路高端封装产业化项目的自筹资金28,258,525.30元，该笔资金已全部置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余金额为23,417,403.58元，其中募集资金存款利息净额为22,235,257.23元，募集资金余额为1,182,146.35元，主要因2008年全球金融危机期间部分进口设备降价从而节约了采购成本。

尚未使用的募集资金用途及去向 截至2010年12月31日，尚未使用募集资金(含利息)为53,348,309.76元，除了需用募集资金支付的29,930,906.18元项目尾款外，募集资金结余(含利息)为23,417,403.58元。上述资金分别存放在交通银行兰州火车站支行和中国民生银行西安经济技术开发区支行募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用及披露不存在问题。

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
DFN型微小形封装集成电路生产线技术改造项目	20,000.00	完成投资19,198.2万元。	项目已实施完毕，效益将在以后年度体现。
合计	20,000.00	-	-

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度公司利润分配预案如下：

1.现金分红预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现利润总额130,945,149.94元，归属于母公司所有者的净利润111,871,226.26元，提取法定盈余公积11,495,064.84元，2010年度未分配利润为100,376,161.42元，加上以前年度尚存未分配利润，2010年度可供股东分配利润合计为380,601,647.25元。

国庙产规模不断扩大科技改造项目的实施需要，公司2010年度不进行现金分红。

2.资本公积转增股本预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司资本公积余额为210,570,031.88元，公司2010年度不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案须经2010年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	14,355,000.00	77,139,928.19	18.61%	294,580,485.83
2008年	0.00	68,538,479.25	0.00%	225,091,276.46
2007年	0.00	80,899,024.11	0.00%	163,251,953.52
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				19.01%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因生产规模不断扩大和技术改造项目的实施需要。	用于技术改造项目及流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
西安天胜电子有限公司	2010年9月11日公司第2010-025号公告	8,000.00	2010年09月28日	4,500.00	信用担保	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		8,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				4,500.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		8,000.00	报告期末对子公司担保实际余额合计(B4)				4,500.00	

公司担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 4.44%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	西安天胜电子有限公司分别于2010年9月28日和10月18日同中国民生银行股份有限公司西安分行签署固定资产贷款借款合同，贷款总计4,500.00万元，贷款期两年。若西安天胜电子有限公司不能按期足额还款，公司应按贷款合同约定按期足额还款。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
厦门永红科技有限公司(原材料)	0.00	0.00%	3,915.43	18.33%
宁波康强电子股份有限公司(原材料)	0.00	0.00%	8,350.71	39.10%
天水华天电子资讯有限公司(原待费)	0.00	0.00%	45.78	14.37%
天水永红家园服务有限公司(原待费)	0.00	0.00%	2.00	0.63%
杭州士兰微电子股份有限公司(集成电路封装费)	7,926.29	7.00%	0.00	0.00%
杭州友旺电子有限公司(集成电路封装费)	3,727.17	3.29%	0.00	0.00%
天水七四九电子有限公司(集成电路封装费)	0.92	0.00%	0.00	0.00%
天水华天传感器有限公司(材料)	0.31	0.12%	0.00	0.00%
天水华天微电子股份有限公司(材料)	1.75	0.69%	0.00	0.00%
天水七四九电子有限公司(材料)	0.48	0.19%	0.00	0.00%
天水华天微电子股份有限公司(包装材料)	81.06	2.56%	0.00	0.00%
天水华天微电子股份有限公司(工程改造、维修、备件等)	260.01	7.66%	0.00	0.00%
天水七四九电子有限公司(备件)	19.69	2.13%	0.00	0.00%
天水永红家园服务有限公司(其他产品)	1.13	0.07%	0.00	0.00%
天水华天传感器有限公司(工程)	10.00	1.17%	0.00	0.00%
天水七四九电子有限公司(水电费)	33.52	11.31%	0.00	0.00%
天水华天传感器有限公司(水电费)	1.27	0.43%	0.00	0.00%
天水永红器材厂(水电费)	75.21	25.37%	0.00	0.00%
天水华天微电子股份有限公司(水电费)	75.16	25.35%	0.00	0.00%
天水华天电子资讯有限公司(水电费)	25.79	8.70%	0.00	0.00%
天水永红器材厂(供暖)	65.88	44.60%	0.00	0.00%
天水永红家园服务有限公司(供暖)	45.79	31.00%	0.00	0.00%
天水七四九电子有限公司(供暖)	14.11	9.55%	0.00	0.00%
天水华天传感器有限公司(供暖)	2.07	1.40%	0.00	0.00%
天水华天微电子股份有限公司(供暖)	5.00	3.39%	0.00	0.00%
合计	12,372.61	-	12,313.92	-

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额462.42万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无差异。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	天水华天微电子股份有限公司	自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份，也不由天水华天科技股份有限公司回购该部分股份。	严格履行承诺。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会的日常工作情况

(一)2010年3月26日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过如下议案：

1、《2009年度监事会工作报告》；

2、《2009年年度报告及摘要》；

3、《2009年度财务决算报告》；

4、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

5、《关于会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、《关于公司2010年日常关联交易的议案》；

7、《2009年度内部控制自我评价报告》；

8、《关于聘请会计师事务所的议案》；

9、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

10、《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》

本次会议决议公告已于2010年3月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)2010年4月25日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：

1、《选举罗华兵先生为公司监事会主席》；

2、公司《2010年第一季度季度报告全文及正文》。

本次会议决议公告已于2010年4月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

(三)2010年7月29日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了公司《2010年半年度报告全文及摘要》。

2010年半年度报告全文及摘要已于2010年7月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

(四)2010年10月26日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了公司《2010年第三季度季度报告全文及正文》。

2010年第三季度季度报告全文及正文已于2010年10月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

(五)2010年12月22日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于非公开发行股票方案的议案》；

3、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

4、《关于非公开发行股票预案的议案》；

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

本次会议决议公告已于2010年12月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、监事会对下列事项发表独立意见

2010年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责：

(一)公司依法运作情况

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》及法运作。公司决策程序合法高效，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司董事及高级管理人员认真履行了职责，没有损害公司、股东利益和违反国家法律、法规及公司章程的行为。

监事会已经审阅了董事会通过的《2010年度内部控制自我评价报告》，对报告不存在异议。

(二)公司财务执行情况

报告期内，根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的2010年度财务审计报告，监事会认为公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2010年度公司财务状况和经营成果。

(三)报告期内募集资金的实际使用情况

参阅董事会编制的《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》，所列募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

(四)DFN型微小形封装集成电路生产线技术改造项目

监事会认真查阅了上述投资项目的相关资料，认为项目投资立位准确，项目预算科学合理，项目实施严谨有效，随着项目的顺利完成，将进一步提高公司DFN型微小形封装集成电路封装能力。

(五)报告期内，公司无收购、出售资产情况。

(六)公司关联交易情况

监事会认为公司关联交易是按市场原则进行，遵循了公开、公平、公正的原则。在公司的关联交易中未发现任何损害公司和股东利益的行为。

(七)《2010年度财务报告》

监事会认为，华天科技财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华天科技2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	国浩审字[2011]第45号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	天水华天科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的天水华天科技股份有限公司(以下简称“华天科技”)财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表，股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是华天科技管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，华天科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华天科技2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
审计报告日期	2011年02月15日
注册会计师姓名	
秦宝 张慕宇	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：天水华天科技股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	364,453,272.58	336,086,350.66	343,544,611.15	172,798,850.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,076,094.58	7,566,997.41	1,050,422.73	111,042.18
应收账款	226,561,223.42	229,891,452.10	195,885,759.17	193,800,285.28
预付款项	54,070,299.63	32,416,476.16	30,896,190.21	26,738,348.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			37,165.26	37,165.26
应收股利				
其他应收款	6,212,092.11	46,122,313.50	13,247,852.99	13,157,106.11
买入返售金融资产				
存货	121,309,079.37	104,808,207.03	94,067,335.33	87,700,420.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	780,682,061.69	756,891,796.86	678,729,336.84	494,343,218.93
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,000,000.00	258,798,475.11		248,798,475.11
投资性房地产				
固定资产	724,097,074.05	560,456,817.98	519,793,691.67	508,648,651.06
在建工程	117,768,448.64	21,162,101.89	54,672,225.84	21,722,288.77
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	94,751,936.93	56,034,528.64	49,108,402.91	19,536,914.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,106,559.52	1,332,545.02		
递延所得税资产	18,098,843.97	17,625,383.31	9,211,056.32	8,787,996.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	960,822,863.11	915,409,851.95	632,785,376.74	807,494,325.96
资产总计	1,741,504,924.80	1,672,301,648.81	1,311,514,713.58	1,301,837,544.89
流动负债：				
短期借款	116,622,700.00	116,622,700.00	110,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融